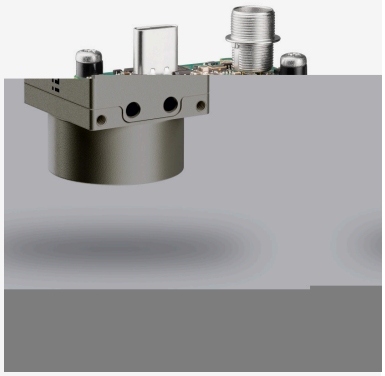
U3-3560XCP-M-NO Rev.1.2 (1008719)

生産終了
このカメラモデルは生産終了となりました。



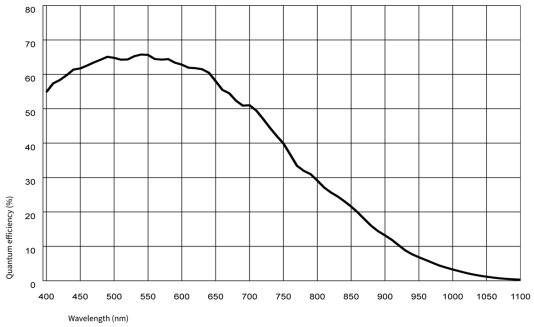




仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	2 MP
有効画素数	2.30 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1920 x 1200 ピクセル
アスペクト比	16:10
ADC	10 bit
色深度 (カメラ)	10 bit
光学センサークラス	1/2.6″
撮像面積	5.760 mm x 3.600 mm
光学センサーの対角	6.79 mm 1/2.6″
画素サイズ	3 µm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Onsemi
センサーモデル	AR0234CSSM00SUKA0
ゲイン (マスター/RGB)	15.1x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	48 / 12
AOI 画像の高さ、ステップ幅	4 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	4 / 2
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング)水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)手法	M/C 自動



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

モデル

フレームレートフリーランモード	101 fps
フレームレートトリガー（連続）	100 fps
フレームレートトリガー（最大）	100 fps
露出時間（最小～最大）	0.012 ms – 446 ms
消費電力	0.5 W – 1 W
画像メモリ	–

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C – 55 ° C / 32 ° F – 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C – 60 ° C / -4 ° F – 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % – 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB 3.0 micro-B、ねじ止め式
I/O コネクター	Wuerth 製 8 ピンコネクター
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクター

1	電圧出 力 3.3 V
2	接地 (GND)
3	オプトカプラなしのフラッシュ出力 – Line 1
4	オプトカプラなしのトリガー入力 – Line 0
5	汎用入出力 (GPIO) 1 – Line 2
6	汎用入出力 (GPIO) 2 – Line 3
7	接地 (GND)
8	USB 給電:5 V、最大 400 mA



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP30
外形寸法	29.0 mm x 29.0 mm x 17.0 mm
重量	61 g
ハウジング素材	亜鉛、ニッケルメッキ

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	–
	Denoiser	–
	Long exposure	–
	Line scan	–
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	–

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

画像調整	Auto exposure	–
	Auto gain	–
	Auto whitebalance	–
	Color correction	–
	Gamma	–
	LUT	–
	Mirror/flip	X/Y
統合画像処理	Pixel formats	Mono8 Mono10g40IDS
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	–
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	–
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
その他	Chunks	–
	Sequencer	–
	Events	–
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.20

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com